

# センシング技術・次世代パッケージング (SenTePack) コンソーシアム

組織概要・活動紹介・入会のご案内

本コンソーシアムは、年10%で急成長を遂げているセンサ・センシング技術、および先進半導体パッケージングの市場動向に対応するため、産総研をプラットフォームとして40以上の企業・研究機関で構成された「センシング技術・次世代パッケージング（SenTePack）コンソーシアム」を2025年4月より運営開始しました。本活動にご興味のある方の新規入会をお待ちしています。

## 活動内容（2025年度の実施予定イベント）

### 研究会・展示会



- 年間3、4回程度の開催を予定
- テーマに沿った講師を招いての講演会
- 入会企業・研究機関の紹介、情報交換・交流、技術紹介など

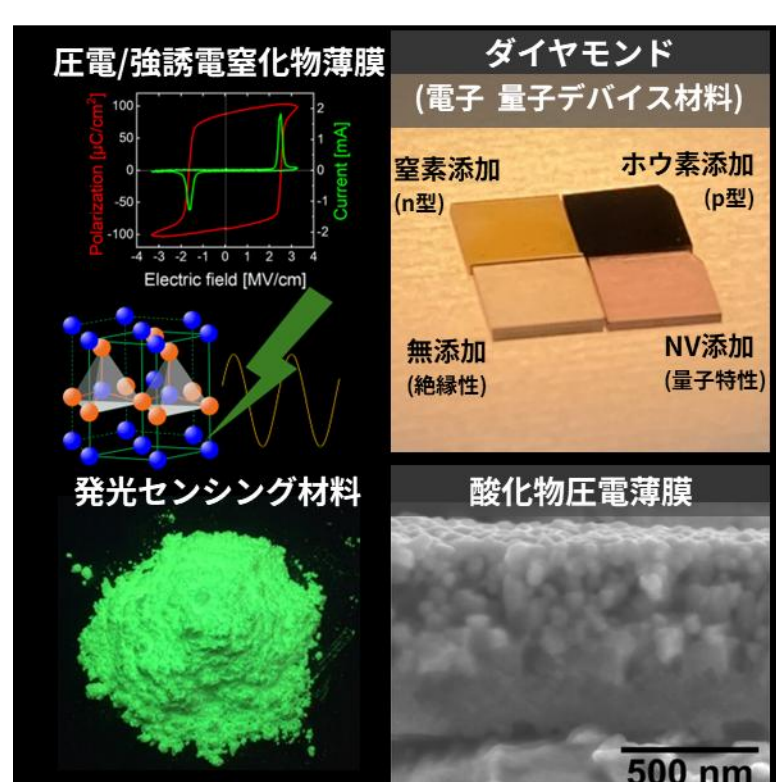
### ワーキンググループ活動



- 下記に記載の4つのワーキンググループを設け、各テーマに沿った活動を展開
- 社会課題・技術課題、内外技術動向・市場動向調査、プロジェクト立案

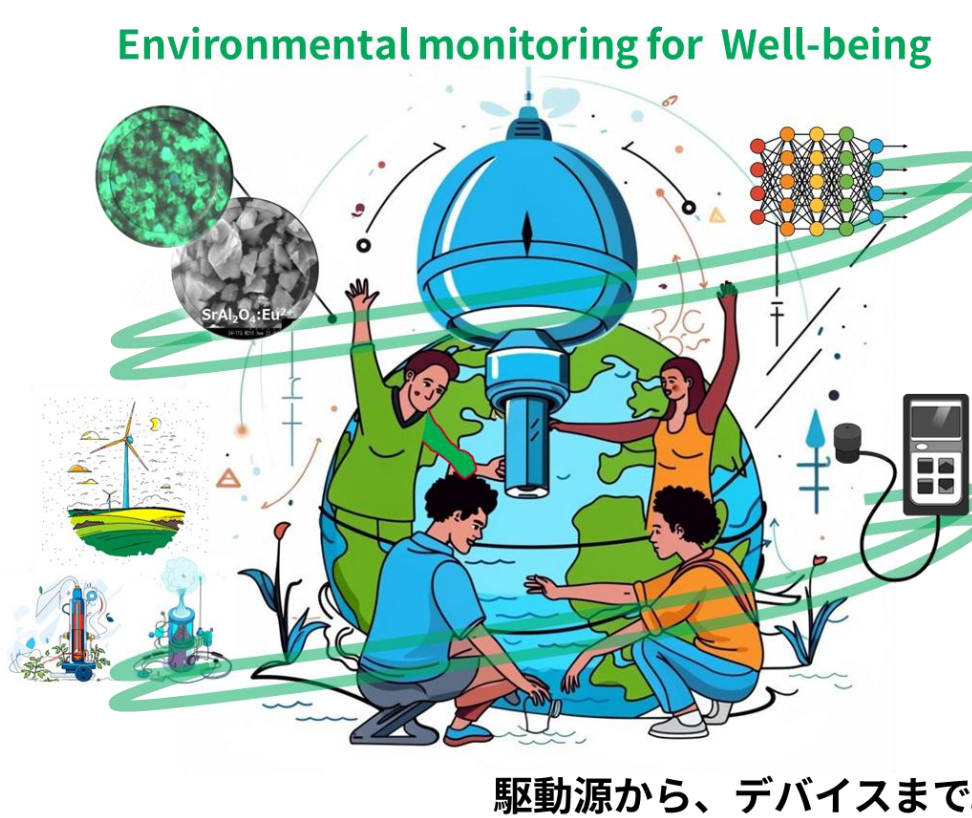
## 各ワーキンググループ（WG）のご紹介

### センシング材料WG



- 世界トップクラスのセンシング材料(窒化物・ダイヤモンド・酸化物圧電体・発光体)の最新情報を紹介
- 薄膜製造プロセス、特性、応用展開などについて議論を展開予定

### 環境モニタリング技術WG



- 持続可能な社会を実現するセンサ技術
- 環境中リスクを数値化・可視化
- 電源からセンサまで包括的に取扱

### 人・機械インタラクションWG



- 人・機械を豊かにするセンサ技術の応用展開
- ウェアラブル、バイオ計測等の応用展開
- 福祉、ロボット等のセンサ技術の出口を議論・調査

### 半導体製造センシング・実装技術WG



- 半導体後工程・実装プロセス技術
- 半導体製造プロセスのスマート化
- 次世代ニーズの掘り起こし

**ご入会いただくことで、同組織の方はどなたでも、何名でも各イベントにご参加いただけます。  
ご検討の方はぜひ下記事務局までお問い合わせください。**